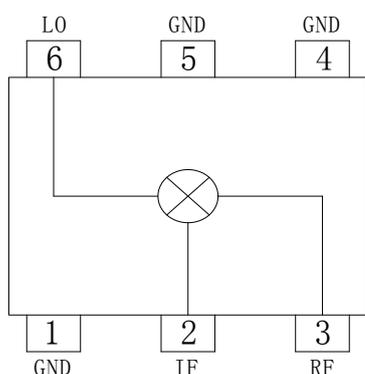


特点:

- 变频损耗: 8.5dB
- 输入 P₋₁: +11dBm
- 本振功率: +13dBm
- SMT 封装
- 封装尺寸: 6.9×7.9×2.85 mm
- 工作温度: -55℃~+85℃

性能参数: (T_A=-55~+85℃)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
射频频率	f _{RF}	f _{RF} =30~2500MHz f _{LO} =30~2500MHz 本振功率: +13dBm Z _{in} =Z _{out} =50Ω	30		2500	MHz	
本振频率	f _{LO}		30		2500	MHz	
中频频率	f _{IF}		30		1600	MHz	
变频损耗	IL			8.5	10.0	dB	
隔离度 (LO to RF)	ISO _{LO to RF}		31	38		dB	
隔离度 (LO to IF)	ISO _{LO to IF}		18	23		dB	
隔离度 (RF to IF)	ISO _{RF to IF}		22	27		dB	
RF 回波损耗	RF _{RL}			-9	-6	dB	
IF 回波损耗	IF _{RL}			-14	-11	dB	
输入 P ₋₁	P ₋₁			+3.0	+8.5		dBm
重量	m				1	g	

功能框图:

极限参数表:

参数名称	极限值
射频最大输入功率	+20 dBm
本振最大输入功率	+20 dBm
装配温度	260℃, 20s
工作温度	-55~+85℃
贮存温度	-55~+125℃
静电防护等级(HBM)	Class 1A

超过以上条件, 可能引起器件永久损坏。

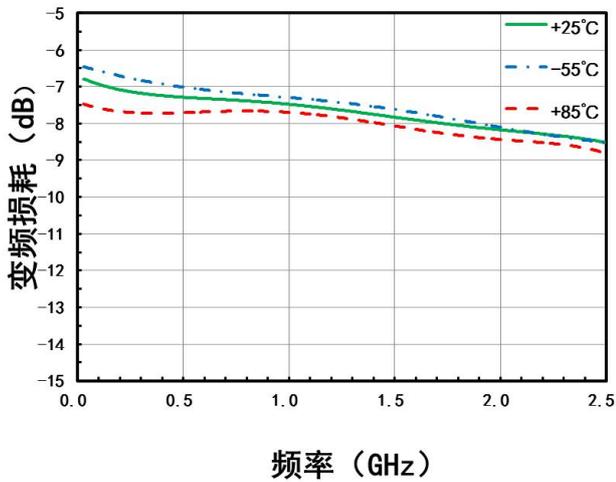
引脚定义:

引脚编号	符号	描述
3	RF_in	射频输入端
6	LO_in	本振输入端
2	IF	中频输出端
1/4/5	GND	接地端

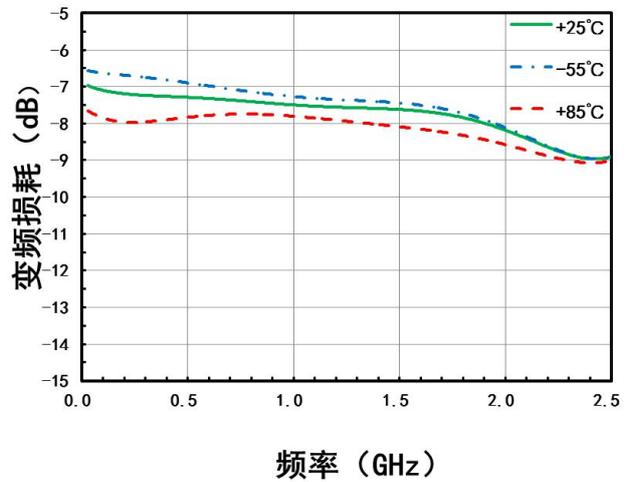


典型测试曲线:

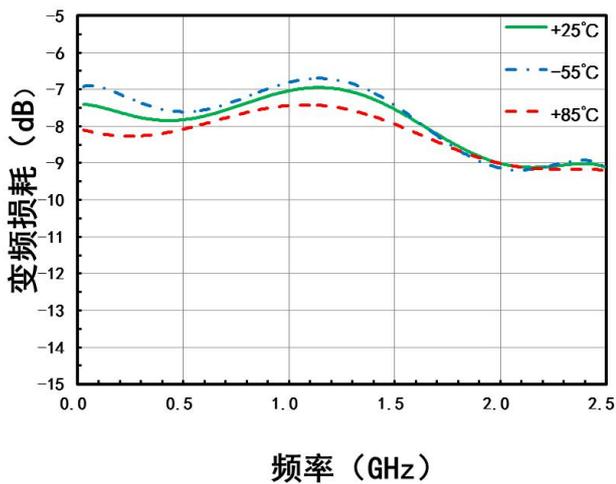
IF=30MHz变频损耗VS. 温度



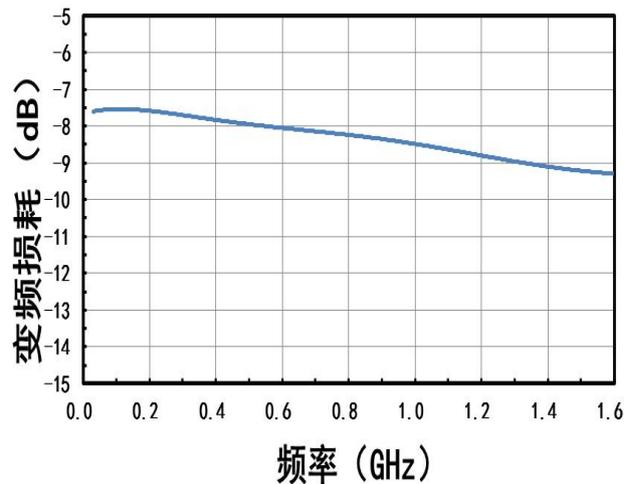
IF=400MHz变频损耗VS. 温度



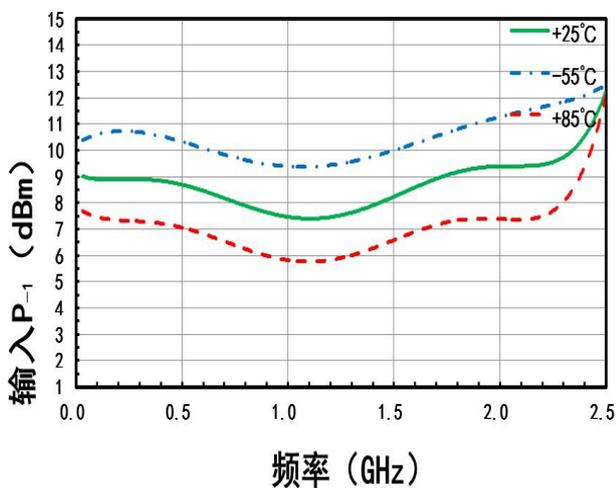
IF=1576MHz变频损耗VS. 温度



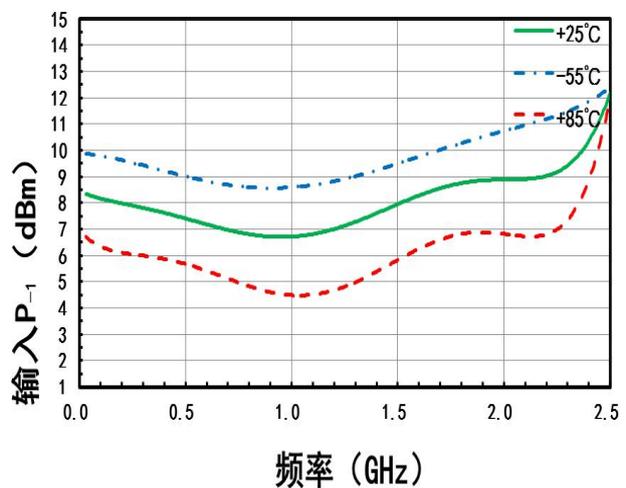
中频带宽



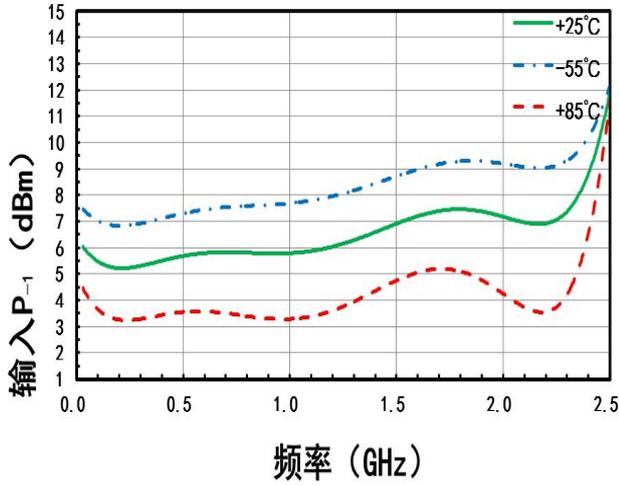
IF=30MHz输入P-1VS. 温度



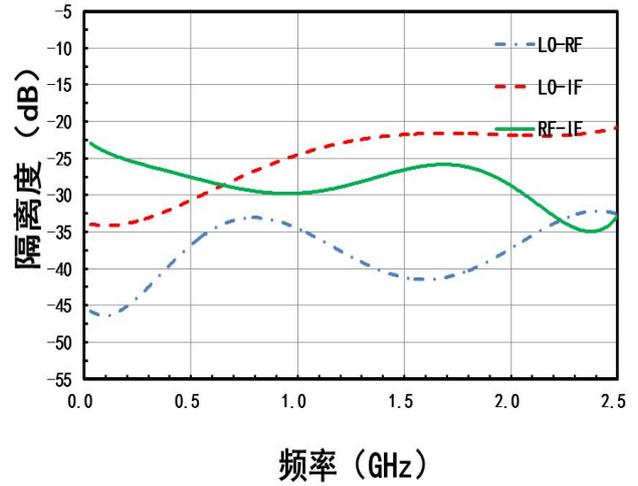
IF=400MHz输入P-1VS. 温度



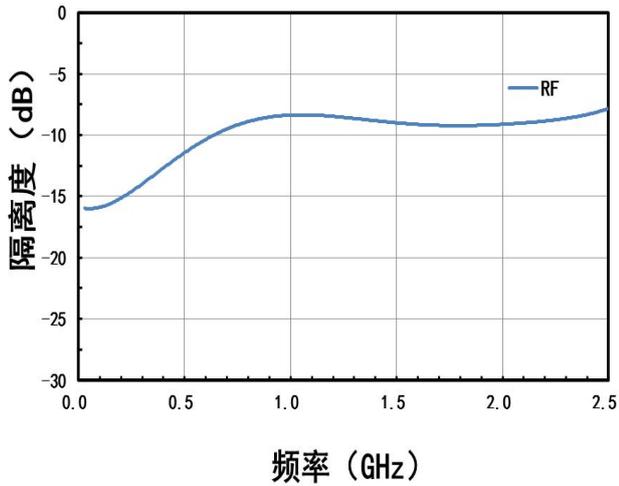
IF=1576MHz输入P₋₁-VS. 温度



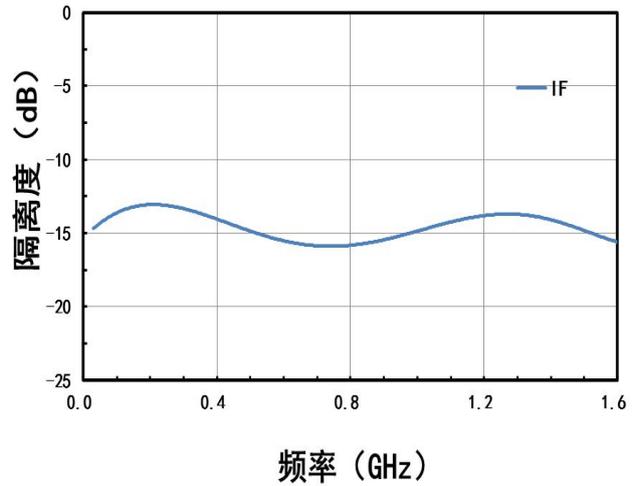
隔离度



RF回波损耗

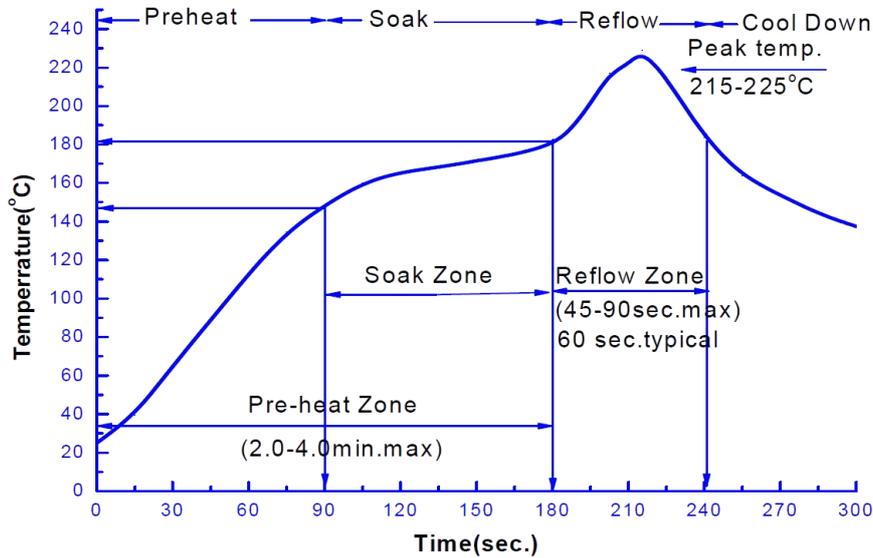


IF回波损耗



产品使用注意事项:

- 1.产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
- 2.产品使用时请保证接地良好；
- 3.产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

- 4.如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。